

# 江苏微导纳米科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 投资者关系活动类别 | <div> <div>■特定对象调研</div> <div>■分析师会议</div> <div>□媒体采访</div> <div>□业绩说明会</div> <div>□新闻发布会</div> <div>□路演活动</div> <div>■现场参观</div> <div>□电话会议</div> <div>□其他（请文字说明其他活动内容）</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 参与单位名称    | CBUS Super 、 Putnam Investments 、 POLYMER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED、Redwheel、DWS Investment GmbH、Coatue Management LLC、Goldman Sachs (Asia) LLC、Allianz Global Investors Asia、Avanda Investment Management Pte Ltd、China Alpha Fund Mgmt (HK) Ltd、Wellington Management Company, LLP 、Carmignac Gestion、Arena Holding Management LLC、Nan Fung Trinity 、Fidelity International、Bernstein、华夏基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国弘资本投资管理有限公司、上海睿华资产管理有限公司、北京健顺投资管理有限公司、上海利位投资管理有限公司、中信信托有限责任公司自营、方正证券股份有限公司、国盛证券资产管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、圆信永丰基金、平安养老保险股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、上银基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司 |    |       |
| 公司接待人员姓名  | CTO LI WEI MIN、董事会秘书龙文、证券事务代表朱敏晓、证券部王少峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| 日期/时间     | 2025 年 9 月 1 日-9 月 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地点 | 公司会议室 |
| 投资者关系活    | 一、公司简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>动主要内容介绍</p> | <p>微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造厂商。公司形成了以原子层沉积（ALD）技术为核心，化学气相沉积（CVD）等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，专注于先进微米级、纳米级薄膜设备的研发、生产与销售，向下游半导体、泛半导体客户提供尖端薄膜设备、配套产品及服务。</p> <p>原子层沉积（ALD）等尖端薄膜沉积技术作为原子级制造的核心关键技术之一，凭借优良的技术特性，具有广泛的普适性，在半导体集成电路、新能源、新材料等领域均有着重要的应用前景。微导纳米相关产品已在半导体、光伏领域实现了大规模产业化应用。</p> <p>在半导体领域内，公司是国内首家成功将量产型 High-k 原子层沉积设备（ALD）应用于集成电路制造前道生产线的国产设备厂商，是国内首批成功开发并进入产业链核心厂商量产线的硬掩膜化学气相沉积设备（CVD）国产厂商，也是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一。目前公司已与国内多家厂商建立了深度合作关系，相关产品涵盖了逻辑、存储、先进封装、化合物半导体、新型显示（硅基 OLED 等）等诸多细分应用领域，多项设备关键指标达到国际先进水平，能够满足国内客户当前技术的需求以及未来技术更迭的需要。</p> <p>在光伏领域内，公司作为率先将 ALD 技术规模化应用于国内光伏电池生产的企业，已成为行业内提供高效电池技术与设备的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了长期合作伙伴关系。同时，公司跟随下游厂商的量产节奏，持续优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电池等新一代高效电池技术，引领光伏行业技术迭代。根据公开的市场数据统计，公司 ALD 产品已连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一。</p> <p>作为国家高新技术企业，公司先后荣获工信部“专精特新”小巨人企业、国家知识产权优势企业、苏南国家自主创新示范区独角兽企业、江苏省小巨人企业（制造类）等称号。公司拥有七个国家级、省级研发平台，包括国家博士后科研工作站、江苏省原子层沉积技</p> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

术工程技术研究中心、江苏省原子层沉积技术工程研究中心、江苏省省级企业技术中心、江苏省外国专家工作室等，并承担了多项国家、省级重大科技专项。

公司以“创新驱动，引领未来，为客户创造价值”为使命，不断引领行业技术创新，成立至今已开发多款高端薄膜沉积设备并成功实现产业化。公司 iTomic HiK 系列半导体 ALD 设备和 KF 系列光伏 ALD 设备均入选江苏省首台（套）重大装备产品目录，半导体多款设备荣获“中国半导体创新产品和技术奖”及“集成电路产业技术创新奖”。

二、主要交流问题及回复

1、2025 年上半年公司的整体业绩如何？半导体领域收入占比和最新情况如何？

2025 年上半年，公司紧抓下游产业链核心客户产能扩张和技术创新机遇，积极拓展半导体业务，取得显著成效，前期战略布局逐步落地。随着 High-k 材料、金属化合物、硬掩膜等先进工艺设备量产规模的不断扩大，以及新工艺设备市场渗透率的不断提升，2025 年上半年公司半导体业务增长强劲，新增半导体设备订单超去年全年水平。截至 2025 年 6 月 30 日，半导体领域在手订单达 23.28 亿元，较年初增长 54.72%。

2025 年上半年，公司实现营业收入 104,994.82 万元，较上年同期增长 33.42%，连续多年保持高速增长。其中，半导体设备收入 19,353.64 万元，同比增长 27.17%。半导体设备收入占主营业务收入比重由 2023 年度的 7.27%提升至 18.45%，呈逐年上升的趋势。同期，公司实现归属于母公司所有者的净利润 19,236.06 万元，同比增长 348.95%；扣除非经常性损益的净利润 13,636.47 万元，同比增长 1,090.38%，盈利能力保持稳健。未来公司将继续加大对半导体业务的战略投入，积极运用可转债募集资金推进先进半导体设备的研发、生产及测试等设施建设，持续提升半导体产品工艺覆盖度，进一步增强市场竞争力。

**2、公司今年在半导体领域的新增订单增长迅速，这主要是哪些设备和产品？**

半导体领域，公司的 iTomic HiK 系列、iTomic MeT 系列 ALD 设备和 iTronix MTP 系列 CVD 设备持续获得量产批量订单，实现多家产业链重要客户导入。iTomic PE 系列 ALD 设备自首台通过客户验收后，市场认可度持续提升，于 2025 年上半年陆续取得多家产业链重要客户订单。iTronix PE 系列 CVD 设备拓展顺利，已获得先进封装领域重要客户订单，客户端验证顺利。iTronix LP 系列 CVD 设备凭借强大的工艺开发能力，实现多项关键工艺的突破，获得产业链核心客户的重复订单。

**3、公司半导体 ALD 设备和 CVD 设备的工艺覆盖情况如何？**

公司 ALD 设备已涵盖了行业所需主流 ALD 薄膜材料及工艺，在高介电常数材料、金属化合物薄膜等领域均实现了产业化应用，量产规模不断增加。CVD 设备在硬掩膜等关键工艺领域已实现产业化突破，进入存储芯片等领域先进器件量产生产线，并持续推出客户所需的多款关键工艺设备。

**4、作为前沿应用市场的先进封装具有良好的市场前景，其具有哪些特点，公司在这方面的进展有哪些值得关注？**

2.5D 和 3D 先进封装技术能满足电子器件更高性能和更小尺寸的需求，特别是在人工智能、高性能算力、存算一体、后摩尔时代、Chiplet 等芯片的先进封装中发挥重要作用。

针对先进封装技术对低温工艺的特定需求，公司推出一系列薄膜沉积设备产品和超低温薄膜沉积工艺方案，能够在 50~200℃ 的温度区间内实现高质量的薄膜沉积，为先进封装技术的突破提供了强有力的支持。目前，公司应用于先进封装领域 iTronix PE 系列 CVD 设备已取得重要客户订单，客户端验证顺利。

**5、公司上半年陆续推出了几款半导体新产品，其中包括目前比较前沿的空间型 ALD 设备，能否详细介绍一下其特点？**

在市场拓展的同时，公司不断开发新技术、推出新产品以满足

下游客户新需求。2025 年上半年，公司用于大规模生产的 iTomic Spatix 系列及四站架构腔体的高产能 ALD、CVD 设备正式推出，成为国内少数具备研发和生产空间型 ALD 设备的厂商之一。

iTomic Spatix 系列空间型 ALD 设备能够单批次处理 12 片晶圆片，快速循环适合量产，前驱体空间独立，颗粒表现优越，节省化学源消耗，大幅度提升产能。该产品能够满足存储芯片等高产能需求，实现高质量 High-k、金属、多元掺杂等薄膜沉积，以及应用于 3D NAND/DRAM/新型存储等各种 MIM 结构。

**6、公司在半导体领域的客户主要是哪些？**

在半导体领域内，公司率先攻克难度较高的逻辑电路栅氧层等工艺并获得了客户的重复订单，为公司向全工艺段覆盖奠定客户基础。公司先后获得逻辑、存储、先进封装、化合物半导体和新型显示领域内多家国内知名半导体公司的商业订单，并与多家国内主流半导体厂商及验证平台签署了保密协议并开展产品技术验证等工作。

**7、公司目前研发团队的构成和稳定性如何？研发投入主要是哪些方面？**

通过长期积累与发展，公司已具有完备的研发体系，并组建了一支具有丰富研发和运营管理经验的研发团队，引入和培养了一批经验丰富的电气、工艺、机械、软件等领域工程师，形成了跨专业、多层次的人才梯队。当前，公司研发人员结构完善合理，经验丰富，研发体系运行有效。截至 2025 年 6 月 30 日，公司在职研发人员 349 人，占公司整体员工数量的 28.05%。

公司多年来保持高比例研发投入，其中超过 60%投入半导体领域。公司半导体领域研发重点包括逻辑、存储、先进封装、新型显示器、化合物半导体等项目。

**8、目前公司可转债已经成功发行，未来几年可转债募投项目的实施会对公司产生哪些影响？**

随着国内半导体市场规模扩大及产业链自主可控需求提升，高端国产薄膜沉积设备需求持续增长。2025 年上半年，公司积极推进

|      |                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>可转债募投项目“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”和“研发实验室扩建项目”的建设。通过建设先进的生产车间，购置先进生产设备和量测设备，提升公司薄膜沉积设备的生产能力、研发能力及科技成果转化能力。项目的实施将有效扩大公司半导体设备的生产规模，解决现有产能瓶颈，满足日益增长的订单需求，巩固竞争优势。</p> |
| 风险提示 | <p>1、以上如涉及对行业的预测、公司发展战略等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>2、电话会议参会名单由会议组织方提供。</p>                                                         |